



## 平成18年3月期 決算短信 (連結)

平成18年5月12日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東京 (市場第二部)  
 コード番号 2760 本社所在都道府県 神奈川県  
 (URL <http://www.teldevice.co.jp>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 砂川 俊昭  
 問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 森 秀樹  
 TEL (045)474-7000

決算取締役会開催日 平成18年5月12日  
 親会社等の名称 東京エレクトロン株式会社 (コード番号: 8035)  
 親会社等における当社の議決権所有比率 69.6%  
 米国会計基準採用の有無 無

### 1. 18年3月期の連結業績 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

#### (1) 連結経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年 3月期	88,290	—	3,100	—	2,630	—
17年 3月期	—	—	—	—	—	—

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益		株主資本 当期純利益率		総資本 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
18年 3月期	1,537	—	16,525	92	16,525	74	10.5	7.2	3.0			
17年 3月期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(注) ①当社は、平成17年3月期までは連結財務諸表を作成しておりませんので、平成17年3月期の連結実績は記載しておりません。

- ②持分法投資損益 18年3月期 一百万円 17年3月期 一百万円  
 ③期中平均株式数(連結) 18年3月期 92,000株 17年3月期 一株  
 ④会計処理の方法の変更 無  
 ⑤売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

#### (2) 連結財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円	%	百万円	%	%	円	銭	
18年 3月期	37,088	—	15,160	—	40.9	164,604	83	
17年 3月期	—	—	—	—	—	—	—	

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年3月期 92,000株 17年3月期 一株

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年 3月期	3,930	—	△ 200	—	△ 3,867	—	798	—
17年 3月期	—	—	—	—	—	—	—	—

#### (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 1社

#### (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

### 2. 19年3月期の連結業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中間期	45,000	—	1,400	—	830	—
通期	92,000	—	3,000	—	1,780	—

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19,347円83銭

※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 企業集団の状況

当社を中心とする企業集団は、当社、親会社及び子会社3社で構成されております。

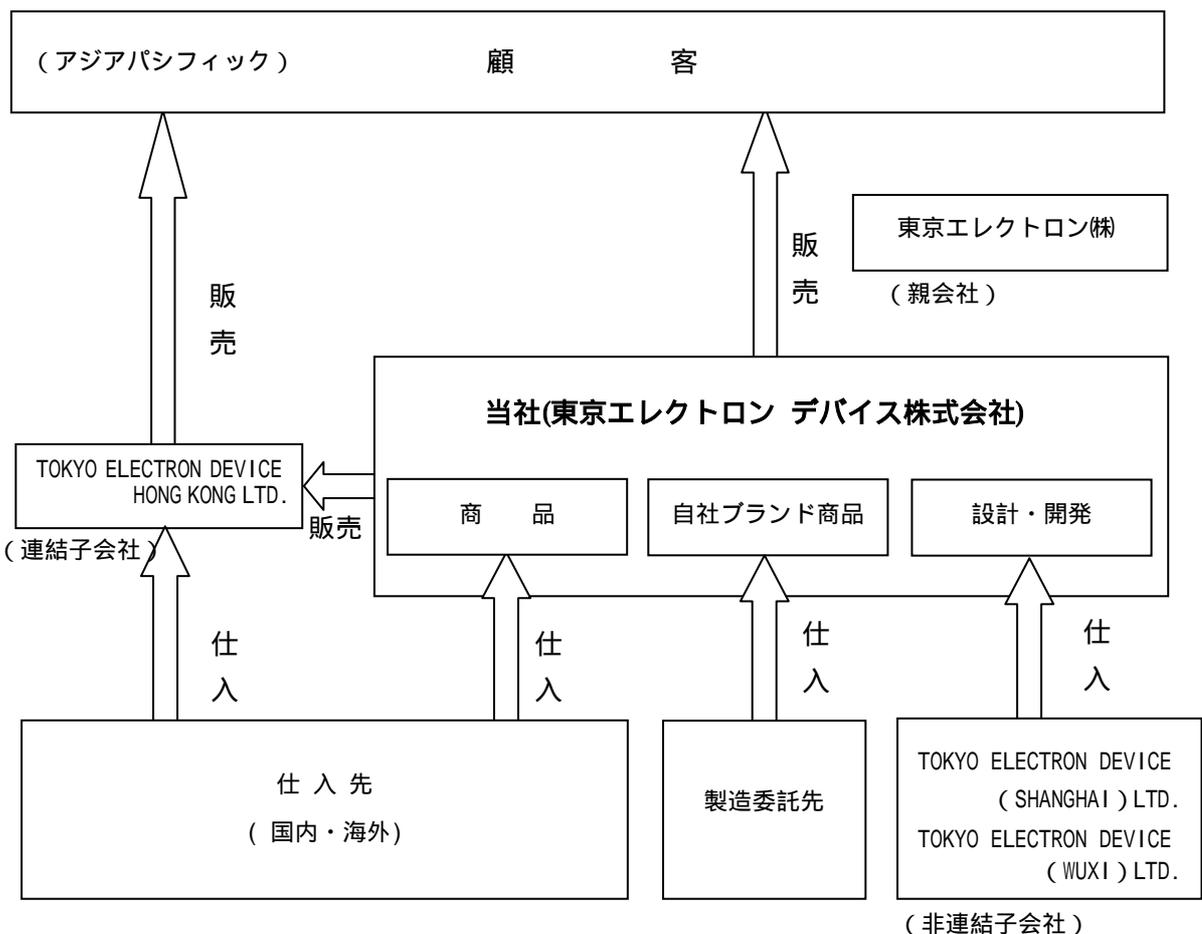
当社グループ(当社及び当社の子会社)は、集積回路を中心とした半導体製品、ボード製品、ソフトウェア、一般電子部品等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品を主として大手エレクトロニクスメーカーに販売しております。

当社の連結子会社である TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. は、アジアパシフィックに生産拠点を展開している日系顧客に対し、エレクトロニクス商品の販売を行っており、また、当社の非連結子会社である TOKYO ELECTRON DEVICE( SHANGHAI )LTD. 及び TOKYO ELECTRON DEVICE ( WUXI ) LTD. は、当社が委託した半導体等の回路設計・開発及びソフトウェアの設計・開発を行っております。

当社の親会社である東京エレクトロン株式会社は、半導体製造装置及び FPD (フラット・パネル・ディスプレイ) 製造装置、コンピュータ・ネットワーク等の産業用エレクトロニクス製品の販売を主な事業としております。

### < 事業の系統図 >

事業の系統図を示すと次のとおりであります。



(注) 1. TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. につきましては、当期より新たに連結子会社となりました。

2. 平成 18 年 1 月に中国無錫に TOKYO ELECTRON DEVICE( WUXI )LTD. を設立しております。

# 経営方針

## 1. 経営の基本方針

当社グループは、技術力向上に努め、高付加価値ビジネスを志向し、安定した利益成長を図り、エレクトロニクス社会の発展へ貢献することを経営の基本方針としております。この基本方針のもと、株主、顧客及び従業員の満足度向上に取り組んで参ります。

## 2. 利益配分に関する基本方針

当社の配当政策は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置づけ、業績連動型・収益対応型配当の継続実施を基本方針としております。

内部留保金につきましては、自社ブランド商品の開発強化及びIT(情報技術)投資の実施等業容拡大のために有効活用するとともに、キャッシュ・フロー重視の経営に注力し利益成長を実現することを通じ、株主各位のご支援にお応えして参る所存であります。

なお、当社は本年6月開催の定時株主総会に、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議において実施できる旨の定款変更を付議する予定としております。定款変更が承認可決されますと配当回数に関する制限がなくなりますが、現時点では四半期配当の実施を予定しておりません。

## 3. 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引下げは、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大に有効な施策であると認識しております。

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えるため、平成15年11月及び平成16年9月にそれぞれ1株につき2株の割合で株式の分割を実施いたしました。

今後につきましては、株価の動向、株式の流動性及び株主構成等を総合的に勘案し、必要に応じて適宜検討して参る所存であります。

## 4. 会社の対処すべき課題

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界は、技術革新による新しい商品の開発や新たなビジネスモデルの創出が繰り返され、常に激しい競争と変化にさらされております。当社グループの顧客であるエレクトロニクスメーカー及び仕入先である半導体メーカーは、グローバルな競争や変化に対応すべく、事業再編や提携、海外進出などの様々な動きを加速させております。このような状況におきまして、半導体商社に期待される役割や機能は従来にも増して広がってきており、競争も今後一層厳しくなるものと予想されます。

当社グループといたしましては、半導体商社としてビジネスをより成長させ、さらに収益性を高めていきたいと考えております。当社グループが成長していくためには、新規商品の開拓に努めるとともに、高付加価値商品の販売に注力し、技術サポートを徹底して、顧客並びに仕入先から信頼される「No.1技術商社」を志向して参ります。また、収益性向上のためには、差別化できる自社ブランド商品の開発が課題であり、その実現のため自社ブランド商品のマーケティングのさらなる強化に努めるとともに、カスタムICを中心とする設計受託業務などの開発ビジネスの強化に努めて参ります。

## 5. 親会社等に関する事項

### (1) 親会社等の商号等

(平成18年3月31日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権所有割合(%)	親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等
東京エレクトロン株式会社	親会社	69.6	株式会社東京証券取引所 市場第一部

### (2) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け及び親会社等との関係

当社は親会社である東京エレクトロン株式会社を中心とする企業グループにおける電子部品部門を担っておりますが、事業上の依存関係はありません。

人的関係については、経営体制の強化、監督機能の強化のため、親会社の役員等(5名)が当社の非常勤役員を兼任しておりますが、出向者の受入れはありません。

親会社を中心とする企業グループに属することによる事業上の制約はなく、当社の事業活動や経営判断を妨げるものではありません。

以上の状況により、親会社からの一定の独立性は確保されていると考えておりますが、一層の独立性の確保のため、親会社から独立した立場の社外取締役の選任を予定しております。今後とも協力関係を継続しながら当社独自の経営を行って参ります。

### (3) 親会社等との取引に関する事項

親会社との重要な取引に関する事項はございません。

## 経営成績及び財政状態

### 1. 当期の概況

当期におけるわが国経済は、原油価格の高騰化など一部に不安要素を抱えながらも、企業収益は改善し、設備投資は増加いたしました。また、好調な企業業績を背景に、雇用情勢に明るさが見られ、個人所得が増加したことから、個人消費も緩やかではありますが増加するなど、景気は回復基調となりました。

当社グループの参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、設備投資の増加や個人消費の増加を背景に、パソコンに対する需要が堅調でありました。また、携帯電話に対する需要につきましても、電子決済などのサービスや機能面が充実してきたこともあり、堅調に推移いたしました。一方、DVDレコーダーや薄型テレビ（PDP・液晶）などのデジタル家電分野につきましては、需要は旺盛であったものの、競争激化による製品価格の下落が続き、収益面において厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは新規顧客の開拓に努め、カスタム IC や汎用 IC（アナログ IC）など、高度な技術サポートを要する高付加価値商品の販売に注力して参りました。また、半導体の設計受託業務の拡大を図り、自社ブランド商品「インレビウム」のマーケティングを推進するなど、開発ビジネスの強化に努めるとともに、当期より営業を開始した香港現地法人の立ち上げに注力するなど、顧客に密着した販売体制の構築に努めて参りました。

当期の業績につきましては、売上高は上期と比較して下期増加したものの、収益面では円安の進行によるコストアップの影響を受けました。この結果、連結売上高は 882 億 9 千万円、連結経常利益は 26 億 3 千万円、連結当期純利益は 15 億 3 千 7 百万円となりました。

なお、当期より連結財務諸表を作成しているため、前期との比較は行っておりません。

当期の連結売上高の品目別の状況は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区 分	第 21 期 （平成 18 年 3 月期）	
	売上高	構成比（％）
半 導 体 製 品	78,235	88.6
ボ ー ド 製 品	4,171	4.7
ソ フ ト ウ ェ ア	3,148	3.6
一 般 電 子 部 品	2,734	3.1
合 計	88,290	100.0

#### 【半導体製品】

設備投資の増加を背景にして FA 関連装置向けや携帯電話基地局向けが堅調であり、また、個人消費の増加を背景にして薄型テレビ（PDP・液晶）向けやカーナビゲーションシステム向けが堅調であったことから、携帯電話端末向け専用 IC の落ち込みを補い、当期の連結売上高は、782 億 3 千 5 百万円となりました。

#### 【ボード製品】

PC マザーボードなど FA 関連装置向けなどの拡販に努めましたが、通信機器向け音声処理ボードが低調であったことなどから、当期の連結売上高は、41 億 7 千 1 百万円となりました。

#### 【ソフトウェア】

企業収益の改善を背景に IT 投資が増加したことから、POS 端末を中心とした組み込みシステム機器向け OS などが堅調であり、当期の連結売上高は 31 億 4 千 8 百万円となりました。

#### 【一般電子部品】

スイッチング電源、液晶ディスプレイ、パネル PC などを中心に拡販に努めましたが、デジタルビデオカメラ用液晶モニターの落ち込みがあったことから、当期の連結売上高は、27 億 3 千 4 百万円となりました。

## 2. キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ1億2千8百万円減少し、7億9千8百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。なお、当期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期との比較分析は行っておりません。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は39億3千万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加及び法人税等の支払いによる資金減少要因があった一方、債権流動化による売上債権の減少及び仕入債務の増加等の資金増加要因がこれを上回ったためであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、2億円となりました。これは主に、本社空調工事費用等の支出及び半導体集積回路用マスク（回路原版）の取得による支出によるものです。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、38億6千7百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出や配当金の支払いがあった一方、新規に短期借入金の増加があったことによるものです。

	第21期
	平成18年3月
自己資本比率	40.9%
時価ベースの自己資本比率	71.2%
債務償還年数	1.2年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	38.9

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

- 1 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- 2 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数により計算しております。
- 3 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

### 3. 次期の見通し

今後の見通しにつきましては、原油価格の高騰などの不安要素はあるものの、景気は引き続き回復傾向を持続するものと予想されます。

当社グループの参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、デジタル家電分野における価格競争が激しさを増しており、収益面では引き続き厳しい環境となることが予想されますが、薄型テレビ（PDP・液晶）を中心に需要は引き続き旺盛であるものと予想されます。また、設備投資の増加を背景に FA 関連装置などの産業機器分野においても堅調に推移するものと予想されます。

こうした状況のもと、平成 19 年 3 月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 920 億円、経常利益 30 億円、当期純利益 17 億 8 千万円を見込んでおります。

平成 19 年 3 月期の配当につきましては、1 株につき年間配当金 6,000 円（中間配当 3,000 円、期末配当 3,000 円）を予定しております。

なお、平成 18 年 5 月 12 日付で、東京エレクトロン株式会社との間で締結した会社分割に関する覚書により、本年 10 月より承継する予定のコンピュータ・ネットワーク事業の売上高は下期 85 億円を見込んでおりますが、業績見通しには反映させておりません。本年 5 月下旬予定の分割契約書締結の際には、承継事業の業績を織り込んだ当期業績見通しを公表いたします。会社分割に関する詳細につきましては、本日付公表の「会社分割の覚書締結に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 4. 事業等のリスク

##### (1) 業績の変動要因について

当社グループは、集積回路を中心とした半導体製品等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品の販売を主な事業としていることから、当社グループの業績は、得意先であるエレクトロニクス業界の半導体需要並びに設備投資動向等の影響を受ける可能性があります。当社グループでは、半導体の中でも付加価値が高く、価格変動が比較的少ない商品の取り扱いを増やすこと等によって、これらの影響を回避する方策を採っておりますが、半導体電子部品の市況が悪化すると当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

##### (2) 為替変動の影響について

当社グループは、エレクトロニクス商品の輸出入取引を行っており、また、一部の国内顧客との間において外貨建取引を行っております。取引発生時と決済時の為替変動リスクに関しては、為替予約によってリスク回避に努めております。また、為替変動による仕入価格の変動に関しては、仕入価格の動向を勘案して販売価格を改定する等の方策を採っておりますが、急激な為替変動は当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

##### (3) 仕入先の依存度について

当社グループの主要な仕入先は、富士通株式会社及びザイリンクス社であり、当期における当社グループの総仕入実績に対する割合はそれぞれ23.2%及び20.8%となっております。各社とは取引基本契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移してきましたが、このような取引関係が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の動向によっては、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

## 連結財務諸表等

当連結会計年度は連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比を行っておりません。

### ① 連結貸借対照表

区分	注記 番号	当連結会計年度 (平成18年3月31日)		構成比 (%)
		金額(千円)		
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金			798,658	
2 受取手形及び売掛金			17,017,502	
3 たな卸資産			15,816,970	
4 繰延税金資産			282,897	
5 未収消費税等			684,728	
6 その他			157,356	
貸倒引当金			△ 8,272	
流動資産合計			34,749,840	93.7
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物		732,728		
減価償却累計額		△ 225,779	506,948	
(2) 工具、器具及び備品		664,147		
減価償却累計額		△ 447,892	216,254	
有形固定資産合計			723,203	1.9
2 無形固定資産				
(1) その他			169,901	
無形固定資産合計			169,901	0.5
3 投資その他の資産				
(1) 繰延税金資産			1,154,660	
(2) その他	※1		291,692	
貸倒引当金			△ 329	
投資その他の資産合計			1,446,023	3.9
固定資産合計			2,339,127	6.3
資産合計			37,088,968	100.0

		当連結会計年度 (平成18年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 買掛金			12,253,808	
2 短期借入金			1,698,223	
3 未払金			862,434	
4 未払法人税等			550,619	
5 賞与引当金			477,325	
6 その他			130,334	
流動負債合計			15,972,746	43.1
II 固定負債				
1 長期借入金			3,000,000	
2 退職給付引当金			2,658,781	
3 役員退職慰労引当金			96,396	
4 その他			200,500	
固定負債合計			5,955,677	16.0
負債合計			21,928,424	59.1
(資本の部)				
I 資本金	※2		2,495,750	6.7
II 資本剰余金			2,054,850	5.6
III 利益剰余金			10,605,677	28.6
IV 為替換算調整勘定			4,266	0.0
資本合計			15,160,544	40.9
負債、少数株主持分 及び資本合計			37,088,968	100.0

② 連結損益計算書

		当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		百分比(%)
I 売上高			88,290,003	100.0
II 売上原価			76,773,514	87.0
売上総利益			11,516,489	13.0
III 販売費及び一般管理費				
1 給料手当		3,119,262		
2 賞与引当金繰入額		478,470		
3 退職給付引当金繰入額		599,819		
4 その他	※1	4,218,857	8,416,409	9.5
営業利益			3,100,079	3.5
IV 営業外収益				
1 受取利息		1,151		
2 受取配当金		5,204		
3 ライセンス収入		15,000		
4 セミナー開催収入		6,456		
5 受取保険配当金		11,782		
6 その他		7,202	46,797	0.1
V 営業外費用				
1 支払利息		100,995		
2 債権譲渡損		116,798		
3 為替差損		292,091		
4 その他		6,442	516,327	0.6
経常利益			2,630,550	3.0
VI 特別利益				
1 固定資産売却益	※2	330		
2 貸倒引当金戻入益		4,153	4,483	0.0
VII 特別損失				
1 固定資産除却損	※3	2,390	2,390	0.0
税金等調整前当期純利益			2,632,643	3.0
法人税、住民税 及び事業税		1,131,636		
法人税等調整額		△ 36,277	1,095,358	1.3
当期純利益			1,537,284	1.7

③ 連結剰余金計算書

		当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	
(資本剰余金の部)			
I	資本剰余金期首残高		—
II	資本剰余金増加高		
1	連結初年度による増加額	2,054,850	2,054,850
III	資本剰余金期末残高		2,054,850
(利益剰余金の部)			
I	利益剰余金期首残高		—
II	利益剰余金増加高		
1	連結初年度による増加額	9,642,392	
2	当期純利益	1,537,284	11,179,677
III	利益剰余金減少高		
1	配当金	552,000	
2	役員賞与	22,000	574,000
IV	利益剰余金期末残高		10,605,677

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益		2,632,643
2 減価償却費		257,916
3 貸倒引当金の増減額		△ 4,153
4 賞与引当金の増減額		45,714
5 退職給付引当金の増減額		△ 6,017
6 役員退職慰労引当金の増減額		1,555
7 受取利息及び受取配当金		△ 6,356
8 支払利息		100,995
9 為替差損益		△ 1,219
10 有形固定資産売却損益		△ 330
11 有形固定資産除却損		2,390
12 売上債権の増減額		4,215,344
13 たな卸資産の増減額		△ 5,151,893
14 仕入債務の増減額		3,644,979
15 未収消費税等の増減額		△ 318,746
16 その他		△ 365,989
小計		5,046,832
17 利息及び配当金の受取額		6,356
18 利息の支払額		△ 100,939
19 法人税等の支払額		△ 1,021,910
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,930,337
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出		△ 178,146
2 有形固定資産の売却による収入		615
3 無形固定資産の取得による支出		△ 36,567
4 その他		13,477
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 200,621
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額		1,684,154
2 長期借入金の返済による支出		△ 5,000,000
3 配当金の支払額		△ 552,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,867,845
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		9,317
V 現金及び現金同等物の増減額		△ 128,810
VI 現金及び現金同等物の期首残高		927,469
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※	798,658

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)
1 連結の範囲に関する事項	<p>(1) 連結子会社の数 1社 連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. の重要性が増加したため、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。</p> <p>(2) 非連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>
2 持分法の適用に関する事項	<p>(1) 持分法を適用した非連結子会社 又は関連会社数 なし</p> <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. (持分法を適用しない理由) 持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p>
3 連結子会社の事業年度等に関する事項	連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法	<p>①デリバティブ 時価法によっております。</p> <p>②たな卸資産 先入先出法による原価法を採用しております。</p> <p>①有形固定資産 当社は定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。在外連結子会社は定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 2～45年 工具、器具及び備品 2～15年</p> <p>②無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売期間(3年以内)に基づく定額法によっております。</p> <p>③長期前払費用 定額法によっております。</p>

項目	当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準	<p>①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社は、主に個別の債権について回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>②賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>③退職給付引当金 当社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>④役員退職慰労引当金 当社は役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく当期末退職金要支給額を計上しております。</p>
(4) 重要なリース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(5) 重要なヘッジ会計の方法	<p>①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：デリバティブ取引(先物為替予約) ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>③ヘッジ方針 為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であり、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。</p>

項目	当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項	連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。
6 利益処分項目等の取扱いに関する事項	連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。
7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。

注記事項

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度 (平成18年3月31日)	
※1	非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。 関係会社出資金 23,845千円
※2	当社の発行済株式の種類及び総数は、次のとおりであります。 普通株式 92,000株
3	売掛債権流動化の目的で、「ローンパーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、参加者へ売却したものととして会計処理した売掛金の金額は3,147,416千円であります。

(連結損益計算書関係)

当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	
※1	研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 148,566千円
※2	固定資産売却益の内訳 工具、器具及び備品 330千円 合計 330千円
※3	固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 267千円 工具、器具及び備品 2,123千円 合計 2,390千円

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	
※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成18年3月31日現在) 「現金及び現金同等物」の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しております。	

(リース取引関係)

有価証券報告書の開示をE D I N E Tにより行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

(当連結会計年度)

開示の対象となる有価証券はありません。

(デリバティブ取引関係)

有価証券報告書の開示をE D I N E Tにより行うため、記載を省略しております。

(退職給付関係)

当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	
1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を併用しております。	
2 退職給付債務に関する事項 (平成18年3月31日現在)	
① 退職給付債務	△4,545,232千円
② 年金資産	1,864,691千円
③ 未積立退職給付債務 (①+②)	△2,680,541千円
④ 未認識数理計算上の差異	△156,237千円
⑤ 未認識過去勤務債務	177,997千円
⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤)	△2,658,781千円
⑦ 前払年金費用	一千円
⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦)	△2,658,781千円
3 退職給付費用に関する事項 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	
① 勤務費用	366,788千円
② 利息費用	85,332千円
③ 期待運用収益	△ 20,895千円
④ 数理計算上の差異の費用処理額	107,080千円
⑤ 過去勤務債務の費用処理額	63,115千円
⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤)	601,420千円
⑦ 厚生年金基金の代行部分返上に伴う 損益	△ 1,601千円
⑧ 計 (⑥+⑦)	599,819千円
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	
① 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
② 割引率	2.00%
③ 期待運用収益率	1.50%
④ 過去勤務債務の額の処理年数	4年
⑤ 数理計算上の差異の処理年数	4年

(税効果会計関係)

当連結会計年度 (平成18年3月31日)	
1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳
	繰延税金資産(流動)
	賞与引当金超過額 192,931千円
	未払事業税否認 46,317千円
	その他 43,648千円
	計 282,897千円
	繰延税金資産(固定)
	退職給付引当金超過額 1,079,465千円
	役員退職慰労引当金超過額 39,136千円
	未払事業税否認 36,057千円
	計 1,154,660千円
	繰延税金資産合計 1,437,557千円
2	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

当社及び連結子会社は、単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2 所在地別セグメント情報

当連結会計年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

3 海外売上高

当連結会計年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(関連当事者との取引)

当連結会計年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

関連当事者との間の取引に重要なものがないので、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	
1株当たり純資産額	164,604円83銭
1株当たり当期純利益	16,525円92銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	16,525円74銭

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり当期純利益	
当期純利益(千円)	1,537,284
普通株主に帰属しない金額(千円)	16,900
(うち利益処分による役員賞与金)	(16,900)
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,520,384
普通株式の期中平均株式数(株)	92,000
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
当期純利益調整額(千円)	—
普通株式増加数(株)	1
(うち新株予約権(株))	(1)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 仕入、受注及び販売の状況

当社グループは半導体電子部品等の専門商社であり、単一の事業活動を営んでいるため、事業部門は設けておりません。

なお、品目別の「仕入、受注及び販売の状況」は次のとおりであります。

### (1) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目	仕入高 (千円)
半導体製品	73,729,508
ボード製品	3,027,719
ソフトウェア	2,679,995
一般電子部品	2,503,520
合計	81,940,745

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目	受注高 (千円)	受注残高 (千円)
半導体製品	79,586,481	6,797,219
ボード製品	4,228,439	452,953
ソフトウェア	3,303,732	212,391
一般電子部品	2,628,867	293,841
合計	89,747,522	7,756,407

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 金額は販売価格によっております。

### (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目	販売高 (千円)
半導体製品	78,235,652
ボード製品	4,171,070
ソフトウェア	3,148,718
一般電子部品	2,734,561
合計	88,290,003

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	金額 (千円)	割合 (%)
松下電器産業株式会社	15,002,923	17.0

## (ご参考)

## ① 連結貸借対照表 (四半期比較)

区分	当第1四半期 (平成17年6月30日)		当第2四半期 (平成17年9月30日)		当第3四半期 (平成17年12月31日)		当第4四半期 (平成18年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	1,192,850		1,110,509		1,182,442		798,658	
2 受取手形及び売掛金	19,299,435		22,699,259		19,138,129		17,017,502	
3 たな卸資産	13,033,930		12,457,967		13,801,031		15,816,970	
4 その他	761,541		705,475		928,760		1,124,982	
貸倒引当金	△ 9,624		△ 10,815		△ 9,226		△ 8,272	
流動資産合計	34,278,133	93.5	36,962,396	94.0	35,041,139	93.8	34,749,840	93.7
II 固定資産								
1 有形固定資産	754,761		743,639		721,991		723,203	
2 無形固定資産	217,807		201,111		181,365		169,901	
3 投資その他の資産	1,406,657		1,404,498		1,415,232		1,446,352	
貸倒引当金	—		—		△ 3,419		△ 329	
固定資産合計	2,379,225	6.5	2,349,249	6.0	2,315,169	6.2	2,339,127	6.3
資産合計	36,657,359	100.0	39,311,645	100.0	37,356,308	100.0	37,088,968	100.0

区分	当第1四半期 (平成17年6月30日)		当第2四半期 (平成17年9月30日)		当第3四半期 (平成17年12月31日)		当第4四半期 (平成18年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	10,260,441		11,772,550		9,788,744		12,253,808	
2 短期借入金	11,063		84,915		533,676		1,698,223	
3 一年以内返済予定 長期借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000		—	
4 賞与引当金	212,213		367,154		241,148		477,325	
5 その他	1,233,283		1,569,456		1,389,675		1,543,388	
流動負債合計	16,717,001	45.6	18,794,075	47.8	16,953,244	45.4	15,972,746	43.1
II 固定負債								
1 長期借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
2 退職給付引当金	2,613,515		2,621,941		2,667,531		2,658,781	
3 役員退職慰労引当金	79,052		84,833		90,615		96,396	
4 その他	193,700		196,200		195,500		200,500	
固定負債合計	5,886,267	16.1	5,902,974	15.0	5,953,646	15.9	5,955,677	16.0
負債合計	22,603,269	61.7	24,697,050	62.8	22,906,891	61.3	21,928,424	59.1
(資本の部)								
I 資本金	2,495,750	6.8	2,495,750	6.4	2,495,750	6.7	2,495,750	6.7
II 資本剰余金	2,054,850	5.6	2,054,850	5.2	2,054,850	5.5	2,054,850	5.6
III 利益剰余金	9,501,411	25.9	10,061,106	25.6	9,894,761	26.5	10,605,677	28.6
IV 為替換算調整勘定	2,079	0.0	2,888	0.0	4,055	0.0	4,266	0.0
資本合計	14,054,090	38.3	14,614,595	37.2	14,449,416	38.7	15,160,544	40.9
負債、少数株主持分 及び資本合計	36,657,359	100.0	39,311,645	100.0	37,356,308	100.0	37,088,968	100.0

② 連結損益計算書（四半期比較）

区分	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		当第2四半期 (自平成17年7月1日 至平成17年9月30日)		当第3四半期 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)		当第4四半期 (自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	18,909,891	100.0	23,712,464	100.0	20,563,511	100.0	25,104,136	100.0
II 売上原価	16,474,597	87.1	20,568,258	86.7	18,033,439	87.7	21,697,218	86.4
売上総利益	2,435,293	12.9	3,144,206	13.3	2,530,072	12.3	3,406,917	13.6
III 販売費 及び一般管理費	2,083,027	11.0	2,058,095	8.7	2,088,036	10.2	2,187,249	8.7
営業利益	352,266	1.9	1,086,110	4.6	442,035	2.1	1,219,667	4.9
IV 営業外収益	7,023	0.0	14,643	0.0	1,703	0.0	23,426	0.0
V 営業外費用	92,457	0.5	148,790	0.6	239,689	1.1	35,390	0.1
経常利益	266,832	1.4	951,964	4.0	204,049	1.0	1,207,703	4.8
VI 特別利益	3,131	0.0	△ 1,191	0.0	△ 1,678	0.0	4,222	0.0
VII 特別損失	1,025	0.0	267	0.0	82	0.0	1,014	0.0
税金等調整前 四半期純利益	268,937	1.4	950,505	4.0	202,288	1.0	1,210,911	4.8
法人税、住民税 及び事業税	111,918	0.6	390,811	1.6	92,634	0.5	536,273	2.1
法人税等調整額	—	—	—	—	—	—	△ 36,277	△ 0.1
四半期純利益	157,019	0.8	559,694	2.4	109,654	0.5	710,915	2.8

③ 連結キャッシュ・フロー計算書（四半期比較）

	当第1四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)	当第2四半期 (自 平成17年7月 1日 至 平成17年9月30日)	当第3四半期 (自 平成17年10月 1日 至 平成17年12月31日)	当第4四半期 (自 平成18年1月 1日 至 平成18年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 税金等調整前当期純利益	268,937	950,505	202,288	1,210,911
2 減価償却費	62,377	63,557	65,666	66,315
3 貸倒引当金の増減額	△ 3,131	1,191	1,830	△ 4,044
4 賞与引当金の増減額	△ 219,322	154,875	△ 126,061	236,224
5 退職給付引当金の増減額	△ 51,284	8,426	45,589	△ 8,749
6 役員退職慰労引当金の増減額	△ 15,789	5,781	5,782	5,781
7 受取利息及び受取配当金	—	△ 226	△ 0	△ 6,129
8 支払利息	21,957	23,020	26,592	29,425
9 為替差損益	△ 389	△ 324	△ 580	74
10 有形固定資産売却損益	—	—	△ 151	△ 178
11 売上債権の増減額	1,918,469	△ 3,365,200	3,557,379	2,104,696
12 たな卸資産の増減額	△ 2,384,190	590,109	△ 1,342,470	△ 2,015,341
13 仕入債務の増減額	1,674,838	1,466,737	△ 1,968,385	2,471,789
14 未収消費税等の増減額	175,774	△ 69,116	△ 207,550	△ 217,853
15 その他	△ 412,139	76,641	345,947	△ 374,049
小計	1,036,106	△ 94,022	605,876	3,498,871
16 利息及び配当金の受取額	—	226	0	6,129
17 利息の支払額	△ 39	△ 44,994	△ 4,310	△ 51,594
18 法人税等の支払額	△ 378,991	△ 6,697	△ 635,846	△ 376
営業活動によるキャッシュ・フロー	657,076	△ 145,487	△ 34,280	3,453,029
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 有形固定資産の取得による支出	△ 132,035	△ 11,693	△ 29,592	△ 4,826
2 有形固定資産の売却による収入	—	—	337	277
3 無形固定資産の取得による支出	△ 11,379	△ 143	△ 17,153	△ 7,891
4 その他	14,187	4,345	△ 5,288	233
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,226	△ 7,490	△ 51,696	△ 12,207
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 短期借入金の純増減額	11,063	71,077	424,597	1,177,417
2 長期借入金の返済による支出	—	—	—	△ 5,000,000
3 配当金の支払額	△ 276,000	—	△ 276,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,937	71,077	148,597	△ 3,822,582
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	2,468	△ 439	9,313	△ 2,024
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	265,381	△ 82,341	71,933	△ 383,784
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	927,469	1,192,850	1,110,509	1,182,442
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,192,850	1,110,509	1,182,442	798,658

④ 連結受注実績推移（四半期比較）

品目	当第1四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)	当第2四半期 (自 平成17年7月 1日 至 平成17年9月30日)	当第3四半期 (自 平成17年10月 1日 至 平成17年12月31日)	当第4四半期 (自 平成18年1月 1日 至 平成18年3月31日)
	受注高 (千円)	受注高 (千円)	受注高 (千円)	受注高 (千円)
半導体製品	18,512,739	20,041,323	20,162,995	20,869,423
ボード製品	838,055	1,154,058	986,888	1,249,437
ソフトウェア	808,571	708,921	874,661	911,577
一般電子部品	1,042,613	407,340	547,961	630,952
合計	21,201,980	22,311,643	22,572,506	23,661,391